

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2025年12月30日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华福证券、华夏基金
会议时间	2025年12月30日 13:30-14:30
会议地点	有研粉材会议室
上市公司接待人员	董事会秘书、财务总监、总法律顾问：姜珊 证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：请简要介绍下公司业务情况？ A1：有研粉材成立于2004年，控股股东中国有研科技集团是国务院国资委所属中央一级企业，有研粉材属于二级中央企业。公司业务分为四个板块。第一个板块是铜基金属粉体材料，目前国内市占率约30%，主要应用于粉末冶金、金刚石工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等下游领域，该板块的公司有有研合肥、有研重冶和境外的有研泰国、英国Makin公司；第二个板块是微电子锡基焊粉材料，目前在国内市场占有率约15%，国内第一，主要应用于微电子的封装/组装，下游领域主要为消费电子，该板块公司有康普锡威及其山东子公司；第三个板块是增材制造用粉体材料（3D打印用粉体材料）板块，运营的公司为有研增材及其山东子公司，3D打印粉体产品主要为生产工艺比较有特色的铝合金粉、高温合金粉、铜合金粉和不锈钢粉，另外有研增材除了3D打印用粉体材料还生产一些高温特种粉体材料如软磁、MIM粉等；第四个板块是电子浆料，与微电子锡基焊粉材料都属于微电子互连材料，有研纳微公司的锡

膏模块也属于锡粉的下游领域，主要用于微电子的封装、半导体组装等，新开发的产品包括纳米级铜粉、银铜粉和镍粉。此外有研纳微公司主要聚焦国家重大专项任务，承担了未来产业的重点技术突破。

Q2：公司目前有几种散热铜粉？有什么区别？

A2：公司目前能够应用在散热场景的铜粉产品共有三类。第一类是新型散热铜粉，这是公司针对高散热需求场景开发的铜粉新产品，可以应用于 GPU 和 NPU 上，主要解决的是风冷散热场景，该产品属于行业首次应用，目前已应用于华为昇腾 910B 芯片；第二类是 MIM 用的铜粉，用于生产针翅状散热基板，应用于 IGBT 散热器中，已累计对外供应 3000 余吨；第三类是 3D 打印铜粉，目前在送验证和推广阶段，还没有大批量供货，主要用于新型液冷散热器和异型导电零部件场景。

Q3：3D 打印产品的主要应用领域有哪些？

A3：目前公司销售的 3D 打印粉体材料主要应用于军工、商业航天等领域，同时民品市场也在积极拓展，已覆盖鞋模、模具、手板等细分场景。

Q4：3D 打印市场目前如何？公司产能能满足需求吗？

A4：当前 3D 打印市场热度依旧高涨，未来仍具备较大的潜在发展空间。有研增材公司目前产能饱和，订单充足，增材山东基地建设在顺利推进中，预计 2026 年 10 月份完成土建施工，11 月份启动设备调试工作。该基地建成后所生产的效益预计将自 2027 年起逐步释放。

Q5：公司在并购方面有计划吗？

A5：公司不排除开展产业整合或并购的可能性，相关布局将优先考虑产业链下游方向，例如通过拓展品类来丰富公司自身产品线等。

Q6：预计 2026 年传统铜粉的加工费会是什么走势？

A6：按照目前趋势来看，铜粉市场中小企业数量多、竞争激烈，预计 2026 年加工费与 2025 年持平或略有下降。

Q7：泰国公司经营情况如何？

A7：泰国公司于 2024 年 6 月正式投产，2025 年已实现扭亏，预计形成规模效应后会有更多贡献。

Q8：预计明年公司盈利能力如何？

A8：公司的传统板块如铜基板块和锡基板块，未来会以调整产品结构、布局高附加值产品、加强新产品的研发为主，如

	<p>铜基板块的散热铜粉、复合铜粉、低松比铜粉，锡基板块的高端锡粉、微细粉等高附加值产品，通过提高产品毛利率提升业绩水平。公司的两个新赛道增材板块和电子浆料板块是主要的业绩增长点，增材板块会随着 3D 打印粉体材料产业基地建设项目的落地实现产能爬坡，形成新的增量。电子浆料板块目前处于客户送样验证的过程，通过超细镍粉、超细铜粉、超细银粉、银包铜粉及其浆料等新产品的研发，增加互连材料的种类，匹配下游头部客户的需求，带动公司业绩增长。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	
日期	2026 年 1 月 7 日